

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

## 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 <u>(请文字说明其他活动内容)</u>
参与单位名称及人员姓名	国盛证券、泰康资产、招商证券
会议时间	2025年5月19日14:00-16:00
会议地点	现场
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：董东峰 证券事务代表：钱云 证券事务专员：张雅婷
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：请问公司收购衡所华威有何战略意义？ 回复：公司和衡所华威均从事半导体芯片封装材料的研发、生产和销售，主要产品均为环氧塑封料，是半导体封装的关键材料。双方在以下多方面均有协同效应，具体如下： (1) 加速国际化布局，扩大海外优质市场份额 公司和衡所华威主要产品均为环氧塑封料，目标客户一致。衡所华威及其前身已深耕半导体封装材料领域四十余年，品牌知名度高，积累了一批全球知名的半导体客户。优质客户对环氧塑封料供应商的筛选和考核标准严格，合格供应商认证周期较长，认证程序复杂。本次收购完成后，公司将借助衡所华威的国际客户资源，加速国际化布局，扩大海外优质市场份额。

	<p>(2) 补强产品矩阵，提升客户服务能力</p> <p>基于下游封装技术、应用场景以及性能特征的不同，环氧塑封料分为基础、高性能、先进封装等三类。在当下的行业格局中，高性能占据主流地位，而先进封装是未来的行业发展方向。本次收购完成后，公司借助衡所华威在先进封装方面所积累的研发优势，迅速推动先进封装材料的研发及量产进度，打破该领域“卡脖子”局面，逐步实现国产替代，打造世界级半导体封装材料企业。</p> <p>(3) 供应链整合，优化采购与运输成本</p> <p>公司与衡所华威主要产品原材料具有高度的重合性。本次并购整合完成后，双方集中采购规模上升，优化供应链及运输管理能力，在采购端与运输方面将获得更高的议价能力及资源支持。衡所华威长期积累的满足海外客户要求的供应链，将为公司产品和市场全球化拓展提供强有力的补充和支持，提高公司国际竞争力。</p> <p>(4) 优化产线布局，提高生产效率</p> <p>环氧塑封料属于配方型产品，根据客户的定制化需求，产品型号较多。本次交易完成后，公司将对不同生产基地的优势产品进行明确分工，各个生产基地更加专注从事细分型号产品的生产，降低生产成本，提高产线的利用效率和生产效率，提高盈利水平。</p> <p>(5) 整合研发资源，提高高性能和先进封装用环氧塑封料研发投入</p> <p>公司与衡所华威同属于环氧塑封料行业，在产品研发、工艺路线上具有较强的互补性和协同效应。本次交易完成后，双方研发充分整合，优势互补，提高研发速度，提升现有成果水平，同时避免重复研发，将节省的研发资源全力投入到高性能和先进封装用环氧塑封料的研发，尽快赶超国际同行水平，打破国外技术垄断。</p> <p>问题二：公司对衡所华威剩余 70% 股权的收购方式</p>
--	--

回复：公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买绍兴署辉等 13 名股东持有的衡所华威 70% 股权并募集配套资金。

问题三：衡所华威在产品体系和技术方面有何优势？

回复：衡所华威的产品体系全面覆盖基础、高性能、先进封装多个层次，在国内外众多细分应用领域处于领先地位。在国内中高端半导体封装材料被外资厂商垄断的背景下，衡所华威立足于高性能封装的同时，积极布局先进封装领域，推动高端产品的产业化。

衡所华威产品结构聚焦于高性能产品的同时，在先进封装领域不断拓展，产品终端应用涉及汽车电子、新能源、第三代半导体、工业领域、消费电子、物联网、光伏等领域，形成了较为显著的产品体系优势。

衡所华威主要以封装技术演进趋势与客户定制化需求为导向，凭借扎实的研发实力与丰富的实践经验，在产品配方与生产工艺等方面进行持续研发与技术攻关，实现从低端到高端产品全面覆盖的技术体系，可实现灵活快速的研发需求响应。

问题四：本次收购完成后对公司业务方面的发展前景有何影响？

回复：本次交易完成后，有利于公司发挥在资金、市场、经营管理方面的协同，扩大业务规模、提高经营业绩。

本次交易完成后，公司将进一步把握衡所华威的经营计划和业务方向，依据其业务特点，将衡所华威发展规划与公司发展战略深度绑定，通过资源共享和优势互补，整合研发资源、补齐产品矩阵、加速国际化布局，实现业务协同发展，控制采购成本和资金运营成本，促进生产效率、经营水平的提升。

问题五：公司未来发展战略

回复：未来，公司将在巩固现有半导体封装材料竞争优势的基础上，以客户定制化需求为牵引，以先进封装技术发展趋势为导向，构建兼具前瞻性与创新性的技术研发体系，持续优化产品结

	<p>构，增强企业核心竞争力。在传统封装用封装材料领域，公司依托既有优势产品加快对外资厂商产品替代，并积极围绕现有客户以及潜在客户的新增需求进行布局并开发特色产品，从而进一步扩大公司业务规模并提升市场占有率；在先进封装材料领域，公司将加快研发进程，继续完善研发测试手段，缩短研发周期；胶黏剂生产车间将进行净化级别提升满足客户对产品颗粒度管控要求。并以此为基础，依托公司在该领域具有创新性与前瞻性的技术与产品布局，积极配合业内主要厂商全面深入开展先进封装材料的技术攻关，逐步实现先进封装用材料全面产业化。</p> <p>公司聚焦于封装材料的研发及产业化，致力于成长为中国半导体以及相关行业封装材料的引领者与全球强有力的竞争者，持续地以打造卓越的全球化企业为目标而努力，为我国半导体及相关行业产业链发展壮大贡献力量。</p> <p>注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年5月19日